

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-051

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
关于公司全资子公司取得国有建设用地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司（以下简称“苏州同淳”）于近日获批项目建设用地，并完成了《国有建设用地使用权出让合同》的签署及土地使用权价款的支付工作。

二、建设用地概况

宗地面积：26,786.88 平方米

地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区绣湖西路南侧庞山路东侧

宗地用途：工业用地

使用权出让年期：50 年

出让价格：人民币 13,358,784.32 元

三、对公司的影响

本次苏州同淳获批项目建设用地事项，有利于推动公司战略发展项目的部署与实施，促进完善公司产业布局，进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东利益。

四、备查文件

《国有建设用地使用权出让合同》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日